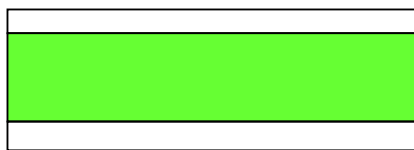


## 新技術紹介

# ガラスエッチング用ドライフィルムレジスト Dry Film Photoresist for glass etching

**HF含有エッチング液によるパターン形成が可能です。**  
This dry film Photoresist applicable to etchant containing fluoric acid.

- アルカリ現像タイプのネガ型ドライフィルムです。  
Negative-working Alkaline Developable Dry Film.
- フッ酸に対して優れた耐性を有します。  
Excellent resistance to fluoric acid.
- ガラス、チタン等のエッチングが可能となります。  
Etching of glass, Ti, etc. is available.
- ラミネートによるレジスト層の形成が可能となります。  
Formation of the resist layer by lamination



キャリアフィルム Carrier Film  
レジスト層 Resist Layer 50umt  
リリースフィルム Release Film

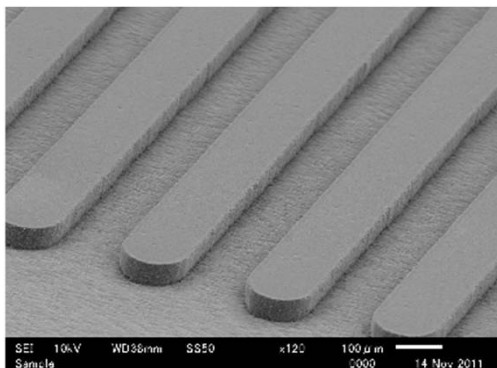


### <加工工程例>

ドライフィルムラミネート → UVパターンニング露光 → アルカリ現像 → ベーク処理  
DFR Lamination                      Pattern Exposure                      Development                      Post Bake

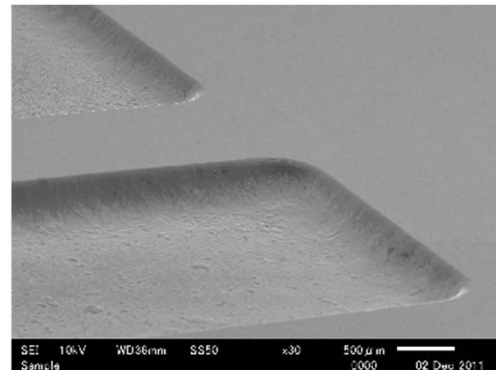
→ HFエッチング → レジスト剥離(アルカリ)  
Etching                                      Stripping

After Development



L/S = 150 / 150 μm

After Etching / Stripping



300 μm depth